

## ● CL-2025-03 パッケージ許容損失

CL-2025-03パッケージにおける許容損失特性例となります。

許容損失は実装条件等に影響を受け値が変化するため、下記実装条件にての参考データとなります。

### 1. 測定条件(参考データ)

測定条件：基板実装状態

雰囲気：自然対流

実装：Pb フリーはんだ

実装基盤：基板 40mm×40mm (片面 1600mm<sup>2</sup>) に対して

銅箔面積 表面 約 50%－裏面 約 50%

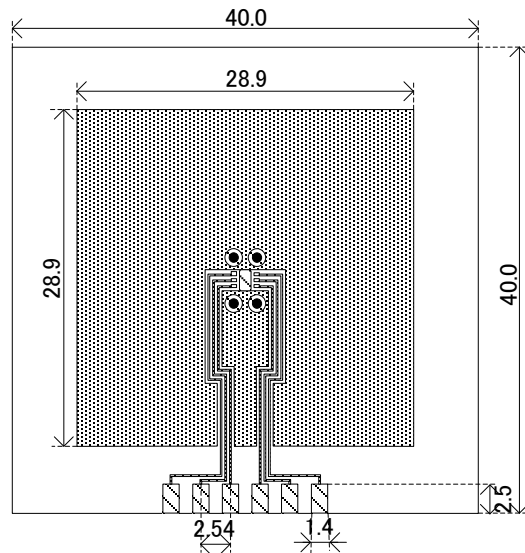
放熱板と周りの銅箔接続

基板材質：ガラスエポキシ (FR-4)

板厚：1.6mm

スルーホール：ホール径 0.8mm 4個

銅箔厚：表面 35um、裏面 35um



評価基板レイアウト(単位:mm)

### 2. 許容損失-周囲温度特性

基板実装(  $T_{imax}=125^{\circ}\text{C}$  )

周囲温度(°C)	許容損失 Pd (mW)		熱抵抗(°C/W)
	Ta max=85°C	Ta max=105°C	
25	800	800	125.00
85	320	320	
105	0	160	
125	0	0	

